

第十八屆電資院傑出校友簡介

◎劉典岳先生 資訊科學系 96 級、資訊科學研究所碩士 98 級◎

現職 聯發科技客製化晶片事業部 Assistant General Manager

學歷

國立清華大學資訊科學研究所碩士，1998

國立清華大學資訊科學系學士，1996

經歷

- 2018 迄今 聯發科技 客製化晶片事業部
- 2016~2017 聯發科技 研發工程集團
- 2015~2016 聯發科技 資訊工程本部
- 2006~2011 聯發科技 設計技術本部(新加坡)
- 2004~2015 聯發科技 設計技術本部
- 1999~2004 矽統科技



專利

- US Patent 6708312: Method for multi-threshold voltage CMOS process optimization, 2004
- JP Patent 4474404: Method of packing-based macro placement and semiconductor chip using the same, 2007
- US Patent 7821038: Power and ground routing of integrated circuit devices with improved IR drop and chip performance, 2010
- US Patent 8072004: Power and ground routing of integrated circuit devices with improved IR drop and chip performance, 2011
- US Patent 8120067: Power and ground routing of integrated circuit devices with improved IR drop and chip performance

傑出成就及貢獻

劉典岳於 1996 年獲資訊科學系學士、1998 年獲碩士，在校期間研究電子設計自動化技術，並熱心參與學生社團服務，擔任研究生聯合學生會長。碩士畢業之後加入矽統科技服國防役，在矽統科技期間建立高效能及低功耗 IC 設計流程，獲選為最佳員工。

2004 年加入聯發科技，負責流程設計及後段技術研發，管理公司全部 IC 後段晶片實現業務。2006 年因應全球化，外派新加坡創立新研發技術團隊據點，從無到有建立超過 100 人的團隊，延攬來自於各地人才，包含新加坡、馬來西亞、中國大陸、印度、越南、以色列及一些歐美專業人士，融合不同的文化並打造技術創新的環境與總部及海外團隊密切合作，承接公司多項重要產品的開發，迄今已成為全球重要研發據點。2010 年為了開發 3G 手機，同時於台灣、新加坡、美國建立 CPU 研發團隊，開啟高效能及多核心 CPU 技術開發。2014 年協助擴充全球研發資源，前往印度 Bangalore 建立設計團隊，並結合當地的技術服務團隊，建立專業及彈性的研發資源，進而因應不同的市場挑戰。2015 年帶領資訊工程團隊優化公司內部 IT 架構並拓展使用 Amazon AWS 雲端資源。2016 年起派駐美國擴展 ASIC 服務事業，開拓新的事業模式。

除了不斷在公司接受新任務新挑戰外，劉典岳校友也常常與業界、學校交流，包括演講、技術經驗分享等，讓更多的學弟妹及學術界能獲取更多的實務經驗，是國際化的最佳榜樣。